



2025年3月期 第1四半期

(2024年4月1日 ~ 2024年6月30日)

決算補足資料

2024年8月9日

ENOMOTO Co.,Ltd.

東証プライム 証券コード:6928

(1)	2025年3月期第1四半期決算	P.3
(2)	2025年3月期業績予想	P.9

(1)2025年3月期第1四半期決算



- ・ 売上高は円安の影響により増加したが、中国経済の停滞により民生・産業機器向けが調整継続
- ・ 物価やエネルギー価格の高騰により、運賃搬送費や荷造費などの販売費が増加し、営業利益は21%減益

単位:百万円	2023/3期 1Q		2024/3期 1Q		2025/3期 1Q		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前期比(%)
売上高	7,243	100.0	6,426	100.0	6,506	100.0	+1.2
売上総利益	1,155	16.0	722	11.2	749	11.5	+3.7
販管費	619	8.5	590	9.2	645	9.9	+9.3
営業利益	536	7.4	132	2.1	104	1.6	△21.2
為替差損益	84	1.2	12	0.2	5	0.1	-
経常利益	638	8.8	162	2.5	135	2.1	△16.5
四半期純利益	431	6.0	96	1.5	47	0.7	△51.4
1株当たり 四半期純利益	64.66円	-	14.52円	-	7.04円	-	

四半期別業績報告(第1四半期)

- ・ 前4Qを底に、業績は回復基調ではあるが、本格的な回復は後半以降
- ・ 国内工場のマイクロコネクタが増加した一方、民生・産機向けのパワー半導体は調整
- ・ 粗利率は改善傾向、販管費は増加したが営業利益は前期4Qを底に回復

単位:百万円	2024/3期					2025/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前同比(%)	4Q比(%)
売上高	6,426	6,593	6,169	6,053	25,244	6,506	+1.2	+7.5
売上総利益	722	642	730	558	2,654	749	+3.7	+34.1
販管費	590	637	626	639	2,494	645	+9.3	+0.9
営業利益	132	4	103	△80	160	104	△21.2	-
為替差損益	12	16	△41	29	17	5	-	-
経常利益	162	27	89	12	291	135	△16.5	+960.0
四半期純利益	96	△9	29	3	121	47	△51.4	+1,091.7

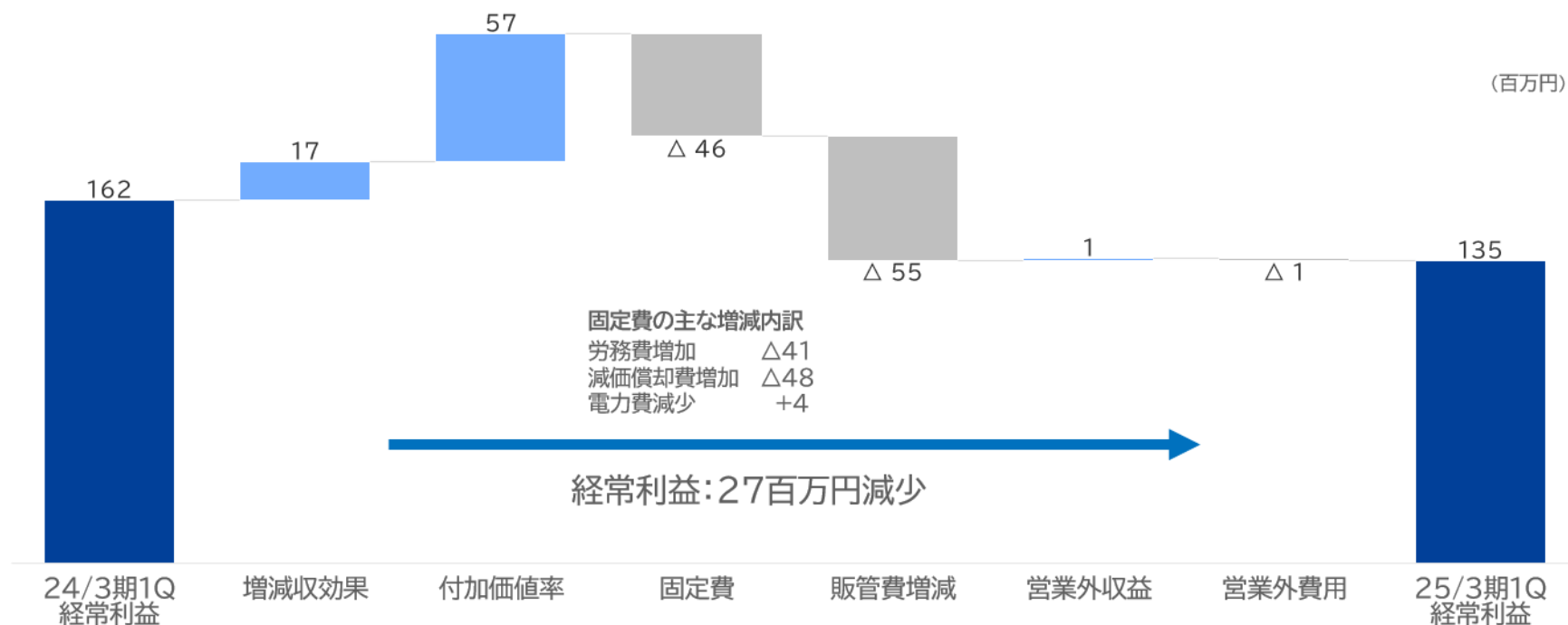
製品群別四半期売上高(第1四半期)

- ・ パワー半導体用リードフレームは、前年同期比では民生・産機向けが大幅な減少、全体の回復は鈍い
- ・ オプト用リードフレームは大型ディスプレイ向けが低迷したが、新規製品の金型販売が始まった
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向け、ウェアラブル端末向けで新規モデル向けの出荷が始まり増収となった

単位:百万円	2024/3期					2025/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前同比(%)	4Q比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	3,164	2,832	2,516	2,598	11,112	2,662	△15.9	+2.4
オプト用 リードフレーム	712	662	648	624	2,647	728	+2.3	+16.6
コネクタ用部品	2,437	2,970	2,863	2,717	10,989	2,959	+21.4	+8.9
その他	112	129	141	112	495	156	+39.4	+39.2
合計	6,426	6,593	6,169	6,053	25,244	6,506	+1.2	+7.5

経常利益増減要因(第1四半期)

- 増減収効果
 - 付加価値率
 - 固定費
- 民生・産機向けパワー半導体用リードフレームが大幅に減少した一方、マイクロコネクタが増加
スマートフォン、ウェアラブル端末向けマイクロコネクタの比率が向上し、製品ミックスは改善
- ①マイクロコネクタの生産による、金型の減価償却費増加
②労務費は賃上げと生産高上昇に伴い増加、電力費は再エネ活用等により減少



用途別量産品売上構成比(第1四半期)

- ・ 車載は、パワー半導体用リードフレームはxEVの成長鈍化が見られ横ばい、エアバッグ向けコネクタは堅調
- ・ スマートフォンは新規モデル向け等の出荷が開始、ウェアラブル向けも増加
- ・ 民生・産機・その他はPC向けを含む汎用パワー半導体、大型ディスプレイ向けのLEDの調整色が依然として濃い

民生・産機・その他

- ・ 構成比は前期の33.1%から 7pt減少
前年同期比20.0%減少
- ・ PC向けを含む汎用パワー半導体用
リードフレームの在庫調整
- ・ 大型ディスプレイ向けの
LED用リードフレームの在庫調整

ウェアラブル

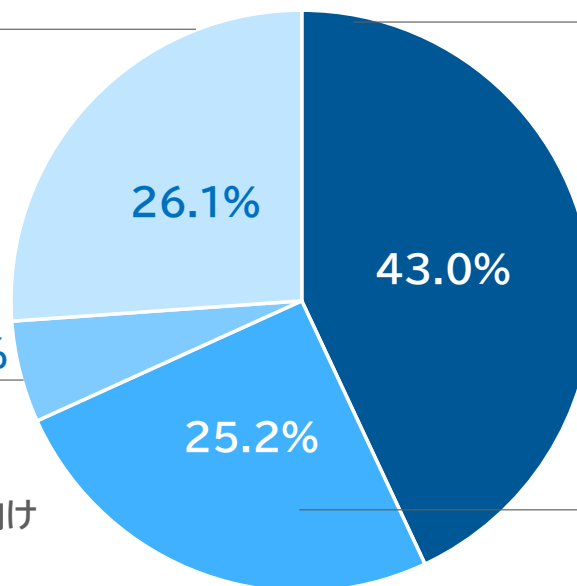
- ・ 構成比は前期の1.1%から 4.6pt増加
前年同期比412.6%増加
- ・ ワイヤレスイヤホンやウォッチ向けが新製品向け
で増加

車載

- ・ 構成比は前期の41.4%から 1.6pt増加
前年同期比5.2%増加
- ・ xEV向けパワー半導体用リードフレームは
横ばい
- ・ エアバッグ向けコネクタ等は堅調

スマートフォン

- ・ 構成比は前期の24.4%から 0.8pt増加
前年同期比4.6%増加
- ・ スマートフォン向けコネクタ部品の新規モデル向け
が出荷開始



(2)2025年3月期業績予想



業績予想

- ・ 第1四半期実績は期初想定線、第2四半期に向けて回復は続くが、下期については依然不透明感あり
- ・ オプト用リードフレームは既存受注案件の順次量産開始により国内生産拠点の稼働率向上、利益率改善
- ・ メッキや樹脂成形が必要な高付加価値製品をターゲットに受注活動強化、製造工程の自動化推進を加速
- ・ 為替及び金融市場における不確実性が高まっており、先行きは不透明

単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	予想	売上比(%)	前期比(%)
売上高	29,265	100.0	25,244	100.0	25,500	100.0	+1.0
売上総利益	4,100	14.0	2,654	10.5	3,150	12.4	+18.7
販管費	2,538	8.7	2,494	9.9	2,550	10.0	+2.2
営業利益	1,561	5.3	160	0.6	600	2.4	+274.4
経常利益	1,805	6.2	291	1.2	600	2.4	+105.5
当期純利益	1,269	4.3	121	0.5	450	1.8	+271.0
1株当たり当期純利益	190.02円	-	18.16円	-	67.38円	-	-
配当金	60.0円	-	70.0円	-	71.0円	-	-

製品群別売上高予想

- ・ パワー半導体向けリードフレームは足下は中国向けの民生・産業機器向けが調整継続、期後半からの底打ちを見込む
- ・ オプト用リードフレームは新規の受注案件が順次量産・出荷開始
- ・ コネクタ用部品は、スマートフォンとウェアラブルの新機種向けが上期から出荷開始、下期は新機種の販売動向次第一方で、車載向けは堅調な推移を見込む

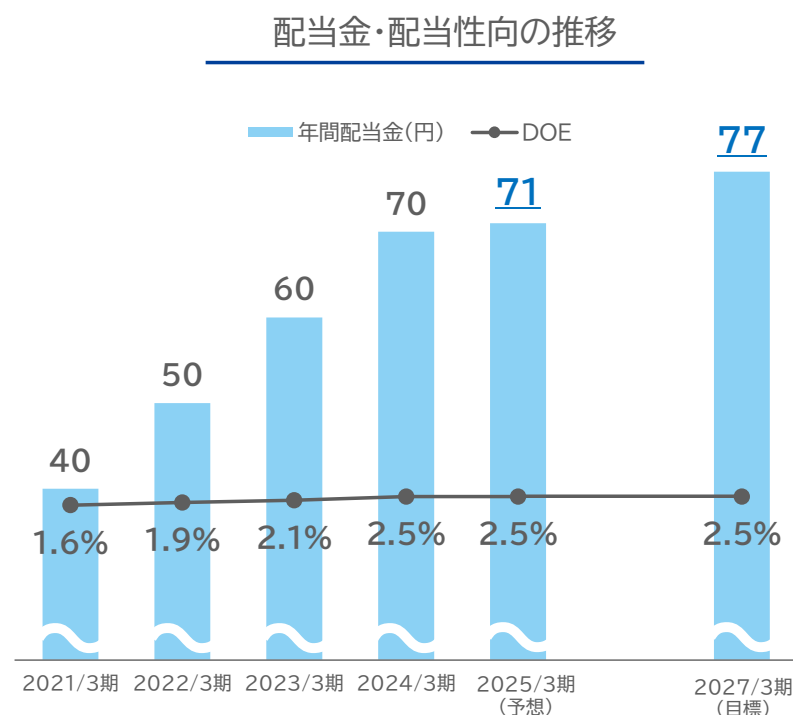
単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		前期比(%)
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	予想	構成比(%)	
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	11,112	44.0	10,500	41.2	△5.5
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	2,647	10.5	3,500	13.7	+32.2
コネクタ用部品	12,912	44.1	10,989	43.5	11,000	43.1	+0.1
その他	659	2.3	495	2.0	500	2.0	+1.0
合計	29,265	100.0	25,244	100	25,500	100.0	+1.0

- 2023年5月に配当方針をDOEをベースに変更、2025/3期は71円への増配を計画
- 機動的な資本政策の実行及び資本効率の向上を通じた株主利益の向上を図るため、自己株式の取得を実施する

2024年3月期以降の配当方針

- DOE*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 次期中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2025年3月期は71円の配当予想 (DOE2.5%)

* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本



自己株式取得の実施

- 株式の種類:
当社普通株式
- 取得株式総数:
35万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 5.1%)
- 取得総額:
7億円(上限)
- 取得期間:
2024年8月26日～2024年12月31日



注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。